

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一一五年及一一四年第一季

公 司 地 址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電 話：(02)8913-1588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8～9
(四)重大會計政策之彙總說明	10～12
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	12
(六)重要會計項目之說明	12～36
(七)關係人交易	37
(八)質押之資產	37
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	37
(十)重大之災害損失	37
(十一)重大之期後事項	37
(十二)其 他	38
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	38～40
2.轉投資事業相關資訊	41～42
3.大陸投資資訊	42～43
(十四)部門資訊	43



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址	Web	kpmg.com/tw

會 計 師 核 閱 報 告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一五年及一一四年三月三十一日之資產總額分別為2,758,617千元及5,249,981千元，分別占合併資產總額之12.85%及24.37%；負債總額分別為398,182千元及943,168千元，分別占合併負債總額之3.94%及9.30%；民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為(20,053)千元及66,193千元，分別占合併綜合損益之(5.29)%及15.20%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，於民國一一五年三月三十一日有關鼎翰科技股份有限公司之部分子公司財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開該等財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。該等子公司於民國一一五年三月三十一日之資產總額為2,656,448千元，占合併資產總額之12.37%；於民國一一五年一月一日至三月三十一日之營業收入淨額為1,014,442千元，占合併營業收入淨額之23.11%。

列入上開合併財務報告之子公司中，於民國一一四年三月三十一日有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一一四年三月三十一日之資產總額為9,467,471千元，占合併資產總額之43.95%；於民國一一四年一月一日至三月三十一日之營業收入淨額為2,084,037千元，占合併營業收入淨額46.23%。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭仰倫
蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一一五年五月八日

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇五年三月三十一日、一〇四年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

	115.3.31		114.12.31		114.3.31			115.3.31		114.12.31		114.3.31	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產													
流動資產：							負債及權益						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,938,409	18	3,535,194	16	3,652,300	17	2100 短期借款(附註六(十))	\$ 1,766,991	8	1,540,103	7	2,079,130	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	90,513	-	60,444	-	90,325	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	59,409	-	67,595	-	66,736	-
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十八))	-	-	69	-	292	-	2170 應付帳款	1,659,493	8	1,656,680	8	1,550,308	7
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	3,220,253	15	3,314,903	16	3,578,008	17	2200 其他應付款(附註六(十二))	732,859	3	892,386	4	721,660	3
1200 其他應收款	109,617	1	113,308	1	119,019	1	2230 本期所得稅負債	190,180	1	159,000	1	283,215	1
1220 本期所得稅資產	4,991	-	4,903	-	93,276	-	2280 租賃負債－流動(附註六(十三))	155,473	1	148,063	1	142,064	1
130X 存貨(附註六(四))	4,113,458	19	3,815,967	18	3,896,880	18	2322 一年內到期長期借款(附註六(十一))	309,029	1	396,973	2	274,218	1
1410 預付款項	436,528	2	348,898	1	315,096	1	2399 其他流動負債	353,157	2	351,281	1	350,763	2
1470 其他流動資產	30,485	-	9,708	-	13,616	-		5,226,591	24	5,212,081	24	5,468,094	25
1476 其他金融資產－流動(附註六(二))	92,580	-	539,520	3	-	-	非流動負債：						
	12,036,834	55	11,742,914	55	11,758,812	54	2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二))	-	-	-	-	28,848	-
非流動資產：							2540 長期借款(附註六(十一))	3,010,998	14	3,123,138	15	2,828,890	13
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	135,494	1	125,237	1	90,955	-	2570 遞延所得稅負債	1,241,807	6	1,224,622	6	1,192,474	6
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,203,917	20	4,270,061	20	4,399,668	21	2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	566,900	3	562,059	2	549,955	3
1755 使用權資產(附註六(七))	684,755	3	686,313	3	665,740	3	2640 淨確定福利負債－非流動	22,878	-	20,916	-	22,419	-
1805 商譽(附註六(九))	1,993,373	9	1,988,321	9	2,069,299	10	2670 其他非流動負債	42,429	-	70,135	-	55,541	-
1822 無形資產(附註六(八))	967,476	5	1,017,928	5	1,131,887	6		4,885,012	23	5,000,870	23	4,678,127	22
1840 遞延所得稅資產	851,254	4	822,051	4	722,531	3		10,111,603	47	10,212,951	47	10,146,221	47
1980 其他金融資產－非流動(附註六(二))	137,944	1	133,764	1	270,561	1	負債總計						
1990 其他非流動資產(附註六(十四))	463,904	2	408,686	2	433,937	2	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十六))						
	9,438,117	45	9,452,361	45	9,784,578	46	3110 普通股股本	2,634,854	12	2,634,854	12	2,634,854	12
							3200 資本公積	2,290,130	11	2,290,130	11	2,255,885	11
							3300 保留盈餘	3,905,387	18	3,734,784	18	3,867,547	18
							3400 其他權益	(175,515)	(1)	(275,634)	(1)	(114,936)	(1)
							3500 庫藏股票	(741,295)	(3)	(741,295)	(3)	(599,878)	(3)
							歸屬母公司業主之權益合計	7,913,561	37	7,642,839	37	8,043,472	37
							36XX 非控制權益(附註六(五))	3,449,787	16	3,339,485	16	3,353,697	16
							權益總計	11,363,348	53	10,982,324	53	11,397,169	53
資產總計	\$ 21,474,951	100	21,195,275	100	21,543,390	100	負債及權益總計	\$ 21,474,951	100	21,195,275	100	21,543,390	100

董事長：王秀亭



經理人：王興磊



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十五年及一十四年一月二日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	115年1月至3月		114年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十八))	\$ 4,560,563	104	4,636,794	103
4190 減：銷貨退回及折讓	<u>170,143</u>	<u>4</u>	<u>128,936</u>	<u>3</u>
營業收入淨額	4,390,420	100	4,507,858	100
5000 營業成本(附註六(四))	<u>3,016,714</u>	<u>69</u>	<u>3,284,622</u>	<u>73</u>
營業毛利	<u>1,373,706</u>	<u>31</u>	<u>1,223,236</u>	<u>27</u>
6000 營業費用(附註六(十四)及(二十))：				
6100 推銷費用	526,011	12	493,064	11
6200 管理費用	267,865	5	227,755	5
6300 研究發展費用	198,327	5	196,603	4
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	<u>1,617</u>	<u>-</u>	<u>2,093</u>	<u>-</u>
	<u>993,820</u>	<u>22</u>	<u>919,515</u>	<u>20</u>
營業淨利	<u>379,886</u>	<u>9</u>	<u>303,721</u>	<u>7</u>
營業外收入及支出(附註六(十九))：				
7100 利息收入	4,193	-	6,259	-
7010 其他收入	9,637	-	9,626	-
7020 其他利益及損失	39,750	1	52,680	1
7050 財務成本	<u>(39,597)</u>	<u>(1)</u>	<u>(49,737)</u>	<u>(1)</u>
	<u>13,983</u>	<u>-</u>	<u>18,828</u>	<u>-</u>
稅前淨利	393,869	9	322,549	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>83,713</u>	<u>2</u>	<u>86,500</u>	<u>2</u>
本期淨利	<u>310,156</u>	<u>7</u>	<u>236,049</u>	<u>5</u>
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	54,531	1	226,056	5
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	<u>14,745</u>	<u>-</u>	<u>(26,615)</u>	<u>1</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>69,276</u>	<u>1</u>	<u>199,441</u>	<u>4</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 379,432</u>	<u>8</u>	<u>\$ 435,490</u>	<u>9</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 170,603	4	116,475	2
非控制權益(附註六(五))	<u>139,553</u>	<u>3</u>	<u>119,574</u>	<u>3</u>
	<u>\$ 310,156</u>	<u>7</u>	<u>\$ 236,049</u>	<u>5</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 270,722	6	246,217	5
非控制權益(附註六(五))	<u>108,710</u>	<u>2</u>	<u>189,273</u>	<u>4</u>
	<u>\$ 379,432</u>	<u>8</u>	<u>\$ 435,490</u>	<u>9</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(二十一))	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 0.47</u>	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十一))	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 0.47</u>	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王興磊

~5~



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一五一年及一四一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票			
民國一四一年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354	3,150,273	10,944,627
本期淨利	-	-	-	-	116,475	116,475	-	-	116,475	119,574	236,049
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	129,742	-	129,742	69,699	199,441
本期綜合損益總額	-	-	-	-	116,475	116,475	129,742	-	246,217	189,273	435,490
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	2,901	-	-	-	-	-	-	2,901	-	2,901
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,151	14,151
民國一四一年三月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,255,885	1,201,264	531,125	2,135,158	3,867,547	(114,936)	(599,878)	8,043,472	3,353,697	11,397,169
民國一五一年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,290,130	1,247,382	302,149	2,185,253	3,734,784	(275,634)	(741,295)	7,642,839	3,339,485	10,982,324
本期淨利	-	-	-	-	170,603	170,603	-	-	170,603	139,553	310,156
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	100,119	-	100,119	(30,843)	69,276
本期綜合損益總額	-	-	-	-	170,603	170,603	100,119	-	270,722	108,710	379,432
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,592	1,592
民國一五一年三月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,290,130	1,247,382	302,149	2,355,856	3,905,387	(175,515)	(741,295)	7,913,561	3,449,787	11,363,348

董事長：王秀亭



經理人：王興磊



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一五五年及一四四年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	115年1月至3月	114年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 393,869	322,549
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	232,467	232,187
攤銷費用	51,493	54,088
預期信用減損損失	1,617	2,093
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(3,641)	476
利息費用	28,506	49,302
利息收入	(4,193)	(6,259)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	5,150	2,064
非金融資產減損迴轉利益	(7)	(204)
其他	-	2,901
收益費損項目合計	311,392	336,648
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產／負債增減	(37,038)	(73,075)
應收票據(增加)減少	69	(280)
應收帳款(增加)減少	93,033	(214,702)
其他應收款(增加)減少	3,677	(24,968)
存貨增加	(297,491)	(18,873)
預付款項(增加)減少	(87,630)	18,886
其他流動資產(增加)減少	(20,777)	8,055
其他金融資產增加	(2,660)	(4,750)
應付帳款增加	2,813	175,964
其他應付款減少	(159,245)	(217,512)
其他流動負債增加(減少)	3,247	(19,142)
淨確定福利負債增加	1,961	1,386
其他非流動負債增加(減少)	27,737	(7,063)
調整項目合計	(160,912)	(39,426)
營運產生之現金流入	232,957	283,123
收取之利息	4,207	4,734
支付之利息	(18,573)	(36,375)
支付之所得稅	(64,639)	(56,617)
營業活動之淨現金流入	153,952	194,865
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,833)	(23,718)
取得不動產、廠房及設備	(79,154)	(41,273)
處分不動產、廠房及設備	275	2,749
取得無形資產	(25,878)	(8,876)
其他金融資產減少	445,420	417,294
其他非流動資產增加	(58,140)	(9,508)
預付設備款增加	(20,083)	(70,230)
投資活動之淨現金流入	254,607	266,438
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	226,888	(207,571)
舉借長期借款	-	951,796
償還長期借款	(178,775)	(1,143,756)
租賃本金償還	(45,029)	(22,145)
存入保證金增加(減少)	(49)	36
非控制權益淨變動	1,592	14,151
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,627	(407,489)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,971)	73,865
本期現金及約當現金增加數	403,215	127,679
期初現金及約當現金餘額	3,535,194	3,524,621
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,938,409	3,652,300

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王興磊



~7~

會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一五年及一一四年第一季
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器之製造與買賣業務及自動辨識系統產品製造與服務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一一五年五月八日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一五年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「涉及依賴自然電力之合約」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

國際會計準則理事會已發布及修正但尚未經金管會認可之準則及解釋，對合併公司可能攸關者如下：

新發布或修訂準則	主要修訂內容	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」	新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。此等三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引，為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎，並將影響所有公司。 • 更具結構化之損益表：根據現行準則，公司使用不同的格式來表達其經營成果，使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表，引入新定義之「營業利益」小計，並規定所有收益及費損，將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。 • 管理階層績效衡量(MPMs)：新準則引入管理階層績效衡量之定義，並要求公司於財務報表之單一附註中，對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。 • 較細分之資訊：新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。	2027年1月1日 註：金管會於民國114年9月25日發布新聞稿宣布我國將於民國117會計年度接軌國際財務報導準則第18號。如公司有提前適用之需求，亦得於金管會認可後，選擇提前適用。

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

合併公司預期下列其他尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」及國際財務報導準則第19號之修正
- 國際會計準則第21號之修正「換算為高度通貨膨脹之表達貨幣」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一四年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(二) 合併基礎

1. 列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			115.3.31	114.12.31	114.3.31	
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	-	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCHE)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %	註4
本公司	鼎翰科技	標籤印表機之製造及買賣業務	35.74 %	35.74 %	35.79 %	註2
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %	註4
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %	註4
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %	註4
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %	註4
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			115.3.31	114.12.31	114.3.31	
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology India Private Limited (TSCIN)	承租資產	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Mosfortico Investments sp. z o.o. (TSCPL)	一般投資	-	100.00 %	100.00 %	註3
鼎翰科技	MGN sp. z o.o. (MGN)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	-	-	註3
鼎翰科技	Bluebird Inc. (BB)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	99.85 %	99.85 %	96.54 %	註5
鼎翰科技及BB	Bluebird Latin America S. de R.L. de CV (BBMX)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	標籤印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	承租資產	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	標籤印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCPL	MGN	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	-	100.00 %	100.00 %	註3
BB	Bluebird USA Inc. (BBUS)	款項代收	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird India R&D Center Private Ltd. (BBIN)	研發及設計企業行動電腦、技術服務	99.00 %	99.00 %	99.00 %	註5
BB	Bluebird Germany GmbH (BBDE)	協助行銷服務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird Europe SL (BBES)	因投標要求而設立	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird Japan Co., Ltd. (BBJP)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	-	-

註1：該公司已於民國一一五年二月二十五日完成清算並解散。

註2：本公司對鼎翰科技具經營控制權，故將其視為具控制能力之子公司。

註3：MGN以8,754千元反向收購TSCPL之所有股份，收購完成後由鼎翰科技持有MGN 100%股權，於民國一一五年二月二十七日經波蘭法院登記完成並正式生效。

註4：民國一一五年三月三十一日及一一四年三月三十一日係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

註5：民國一一四年三月三十一日係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

(四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

(五)組織重組

依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國107年10月26日發布之IFRS問答集「共同控制下企業合併之會計處理疑義」所述，由於國際財務報導準則第3號「企業合併」對於共同控制下之企業合併並無明確規定，致集團內之組織重組其會計處理仍應適用我國已發布之相關解釋函之規定並採用帳面價值法。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須對未來(包括氣候相關風險及機會)作出判斷及估計，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一四年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一四年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
現金及零用金	\$ 1,368	544	751
支票及活期存款	3,115,317	3,064,247	2,967,753
定期存款	1,006,884	1,099,843	912,446
減：原始到期日超過三個月以上之定期存款(附註六(二))	(185,160)	(629,440)	(228,650)
	<u>\$ 3,938,409</u>	<u>3,535,194</u>	<u>3,652,300</u>

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十二)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	<u>115.3.31</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.3.31</u>
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
受益憑證	\$ 90,364	60,053	90,325
遠期外匯合約	149	391	-
	<u>\$ 90,513</u>	<u>60,444</u>	<u>90,325</u>
其他金融資產：			
原始到期日超過三個月至一			
年內之定期存款	<u>\$ 92,580</u>	<u>539,520</u>	<u>-</u>
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
或有對價	\$ 59,143	67,420	64,350
遠期外匯合約	266	175	2,386
	<u>\$ 59,409</u>	<u>67,595</u>	<u>66,736</u>
非 流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
國外基金	<u>\$ 135,494</u>	<u>125,237</u>	<u>90,955</u>
其他金融資產：			
原始到期日超過一年以上			
之定期存款	\$ 92,580	89,920	228,650
存出保證金	45,364	43,844	41,911
	<u>\$ 137,944</u>	<u>133,764</u>	<u>270,561</u>
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
或有對價	<u>\$ -</u>	<u>-</u>	<u>28,848</u>

合併公司已於附註六(二十二)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.從事衍生金融工具係為規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

115.3.31				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 3,000 / NTD 95,809	美元兌台幣	115.04	
114.12.31				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 2,000 / NTD 62,734	美元兌台幣	115.01	
賣出/買入遠期外匯	EUR 3,000 / NTD 110,950	歐元兌台幣	115.03	
114.3.31				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 4,000 / NTD 131,917	美元兌台幣	114.04	
賣出/買入遠期外匯	EUR 1,000 / NTD 34,331	歐元兌台幣	114.04	

(三)應收票據及應收帳款

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
應收票據	\$ -	69	292
應收帳款	3,302,773	3,397,201	3,646,505
減：備抵損失	(82,520)	(82,298)	(68,497)
	<u>\$ 3,220,253</u>	<u>3,314,972</u>	<u>3,578,300</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

115.3.31			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,451,863	0.46%	6,657
逾期1~90天	66,736	0.98%	654
逾期91~180天	12,081	3.92%	474
逾期181~270天	1,866	12.73%	238
	<u>\$ 1,532,546</u>		<u>8,023</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.12.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,444,662	0.39%	5,669
逾期1~90天	82,275	1.63%	1,345
逾期91~180天	3,919	44.03%	1,725
逾期181~270天	582	12.68%	74
逾期271~365天	32	58.82%	19
	<u>\$ 1,531,470</u>		<u>8,832</u>

	114.3.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,561,562	0.32%	5,357
逾期1~90天	84,482	0.68%	573
逾期91~180天	71	0.98%	1
逾期181~270天	296	56.07%	166
	<u>\$ 1,646,411</u>		<u>6,097</u>

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	115.3.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,334,235	1.28%	17,115
逾期1~90天	353,041	1.00%	3,530
逾期91~180天	10,930	3.00%	328
逾期181~270天	13,336	5.00%	667
逾期271~365天	6,476	10.00%	648
逾期365天以上	52,209	100.00%	52,209
	<u>\$ 1,770,227</u>		<u>74,497</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,455,375	1.08%	15,731
逾期1~90天	285,678	1.00%	2,857
逾期91~180天	55,736	3.00%	1,672
逾期181~270天	15,427	5.00%	771
逾期271~365天	1,277	10.00%	128
逾期365天以上	52,307	100.00%	52,307
	<u>\$ 1,865,800</u>		<u>73,466</u>

	114.3.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,543,771	1.01%	15,566
逾期1~90天	277,125	1.00%	2,771
逾期91~180天	115,608	3.00%	3,468
逾期181~270天	12,865	5.00%	643
逾期271~365天	12,294	10.00%	1,229
逾期365天以上	38,723	100.00%	38,723
	<u>\$ 2,000,386</u>		<u>62,400</u>

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
期初餘額	\$ 82,298	64,146
本期認列之減損損失	1,617	2,093
匯率變動之影響	(1,395)	2,258
期末餘額	<u>\$ 82,520</u>	<u>68,497</u>

民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日，合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)存 貨

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
製成品	\$ 1,573,100	1,427,256	1,502,908
半成品及在製品	1,036,934	977,161	829,684
原物料	1,354,606	1,215,317	1,317,489
在途存貨	148,818	196,233	246,799
	<u>\$ 4,113,458</u>	<u>3,815,967</u>	<u>3,896,880</u>

合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為3,010,633千元及3,246,775千元。民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為6,081千元及37,847千元。

民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之 國 家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		115.3.31	114.12.31	114.3.31
鼎翰科技	台灣	64.26 %	64.26 %	64.21 %

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
流動資產	\$ 6,067,504	5,900,035	5,892,626
非流動資產	6,786,968	6,749,836	6,693,747
流動負債	(3,502,924)	(3,404,381)	(3,845,782)
非流動負債	(3,776,416)	(3,850,743)	(3,431,265)
淨資產	<u>\$ 5,575,132</u>	<u>5,394,747</u>	<u>5,309,326</u>
非控制權益期末帳面金額	<u>\$ 3,449,787</u>	<u>3,339,485</u>	<u>3,353,697</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	115年1月至3月	114年1月至3月
營業收入	\$ <u>2,765,539</u>	<u>2,856,093</u>
本期淨利	\$ 217,110	185,338
其他綜合損益	(38,316)	5,656
綜合損益總額	\$ <u>178,794</u>	<u>190,994</u>
歸屬於非控制權益之本期淨利	\$ <u>139,553</u>	<u>119,574</u>
歸屬於非控制權益之綜合損益總額	\$ <u>108,710</u>	<u>189,273</u>
	115年1月至3月	114年1月至3月
營業活動現金流量	\$ 30,467	225,082
投資活動現金流量	(114,250)	(54,850)
籌資活動現金流量	(9,597)	(502,847)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,260)	31,338
現金及約當現金淨減少數	\$ <u>(109,640)</u>	<u>(301,277)</u>

(六)不動產、廠房及設備

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 及 其 他 設 備	總 計
帳面金額：				
民國115年1月1日	\$ <u>867,161</u>	<u>907,938</u>	<u>2,494,962</u>	<u>4,270,061</u>
民國115年3月31日	\$ <u>867,025</u>	<u>902,772</u>	<u>2,434,120</u>	<u>4,203,917</u>
民國114年1月1日	\$ <u>866,666</u>	<u>886,799</u>	<u>2,660,972</u>	<u>4,414,437</u>
民國114年3月31日	\$ <u>867,064</u>	<u>887,572</u>	<u>2,645,032</u>	<u>4,399,668</u>

- 截至民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日止，合併公司之不動產、廠房及設備作長期借款及融資擔保之明細，請詳附註八。
- 本公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日購置不動產、廠房及設備利息費用資本化金額分別為141千元及244千元，資本化利率分別為2.12%及1.74%。

(七)使用權資產

	土地使用權	房屋及建築	機器設備	運輸設備	總 計
帳面金額：					
民國115年1月1日	\$ <u>7,653</u>	<u>652,241</u>	<u>14,582</u>	<u>11,837</u>	<u>686,313</u>
民國115年3月31日	\$ <u>7,785</u>	<u>642,993</u>	<u>19,108</u>	<u>14,869</u>	<u>684,755</u>
民國114年1月1日	\$ <u>7,987</u>	<u>666,408</u>	<u>16,038</u>	<u>10,648</u>	<u>701,081</u>
民國114年3月31日	\$ <u>8,063</u>	<u>630,941</u>	<u>16,501</u>	<u>10,235</u>	<u>665,740</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(八)無形資產

帳面金額：	顧客關係	電腦軟體	商標權	專門技術	專利權	其他	合 計
民國115年1月1日	\$ 669,088	146,109	79,619	52,929	5	70,178	1,017,928
民國115年3月31日	\$ 631,309	152,976	71,533	46,464	-	65,194	967,476
民國114年1月1日	\$ 742,592	152,650	102,168	81,934	80	69,059	1,148,483
民國114年3月31日	\$ 745,447	143,847	98,289	75,935	61	68,308	1,131,887

(九)商 譽

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
成 本			
期初餘額	\$ 1,988,321	2,029,444	2,029,444
匯率變動之影響	(4,948)	(41,123)	39,855
期末餘額	\$ 1,993,373	1,988,321	2,069,299

合併公司已分攤商譽至整流器部門及條碼列印機部門之現金產生單位，商譽分攤列示如下：

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
整流器部門現金產生單位	\$ 81,779	80,335	84,872
條碼列印機部門現金產生單位	1,911,594	1,907,986	1,984,427
	\$ 1,993,373	1,988,321	2,069,299

條碼列印機部門商譽之整體帳面金額係分攤至下列現金產生單位：

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
印表機事業群	\$ 896,532	880,700	930,438
標籤紙事業—DLS品牌	205,811	202,177	213,595
標籤紙事業—MGN品牌	218,747	223,997	219,986
行動裝置事業—Bluebird品牌	590,504	601,112	620,408
合 計	\$ 1,911,594	1,907,986	1,984,427

(十)短期借款

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
無擔保銀行借款	\$ 1,345,332	1,118,941	1,740,946
進出口貸款	415,935	408,590	332,050
擔保銀行借款	5,724	12,572	6,134
	\$ 1,766,991	1,540,103	2,079,130
尚未使用額度	\$ 4,951,995	4,960,518	5,041,062
利率區間(%)	1.79%~4.36%	1.79%~4.70%	1.77%~7.55%

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(二十二)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註八及九。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十一)長期借款

115.3.31			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.525%	118.03.15	\$ 427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	108,890
	1.325%	116.07.16	85,334
	1.825%	115.12.04	6,917
	1.325%	115.12.04	8,205
	1.840%~1.870%	117.06.19	1,425,000
擔保銀行借款(註)	2.378%~3.826%	118.11.14	<u>1,103,361</u>
小 計			3,325,807
減：未攤銷餘額			(5,780)
減：一年內到期部分			<u>(309,029)</u>
合 計			<u>\$ 3,010,998</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,723,170</u>

114.12.31			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.525%	118.03.15	\$ 427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	101,333
	1.825%	115.12.04	20,793
	1.79%~1.85%	117.06.19	1,600,000
	2.38%~3.87%	118.11.14	<u>1,103,869</u>
擔保銀行借款(註)			3,526,285
小 計			(6,174)
減：未攤銷餘額			(396,973)
減：一年內到期部分			<u>(396,973)</u>
合 計			<u>\$ 3,123,138</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,723,170</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.3.31		
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.675%	119.01.15	\$ 13,660
	1.525%	118.03.15	427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	149,333
	1.825%	115.12.04	17,292
	1.325%	115.12.04	20,513
	1.83%~1.93%	117.03.14	1,100,000
擔保銀行借款(註)	2.38%~4.42%	118.11.14	<u>1,109,421</u>
小 計			\$ 3,110,509
減：未攤銷餘額			(7,401)
減：一年內到期部分			<u>(274,218)</u>
合 計			<u>\$ 2,828,890</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,723,170</u>

註：鼎翰科技以收購取得BB公司之股權設質作為擔保，此筆借款金額係用於支應收購BB公司所需支付之現金對價及相關費用。

合併公司以資產設定抵押供銀行借款之擔保情形請詳附註八。

(十二)其他應付款

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
應付薪資及獎金	\$ 364,958	477,464	334,724
應付設備款	31,952	36,753	36,630
其 他	<u>335,949</u>	<u>378,169</u>	<u>350,306</u>
	<u>\$ 732,859</u>	<u>892,386</u>	<u>721,660</u>

(十三)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
流動	\$ 155,473	148,063	142,064
非流動	<u>566,900</u>	<u>562,059</u>	<u>549,955</u>
	<u>\$ 722,373</u>	<u>710,122</u>	<u>692,019</u>

到期分析請詳附註六(二十二)金融工具。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

租賃認列於損益之金額如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
租賃負債之利息費用	\$ 10,356	13,089
轉租使用權資產之收益	\$ 616	2,733
短期租賃之費用	\$ 2,383	3,359
低價值租賃資產之費用	\$ 3,601	5,162

合併公司承租若干建築物、運輸設備及機器設備做為辦公室、廠房、公務車及日常營運使用，租賃期間為1~11年。位於美國之辦公室及倉庫租賃約定每年依2.5%至10.8%費率調增租賃給付；於印度之辦公室約定每年依4%至5%費率調整租賃給付。

認列於現金流量表之金額如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
租賃之現金流出總額	\$ 61,369	43,755

(十四)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一四年及一一三年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
營業成本	\$ 46	48
推銷費用	9	9
管理費用	103	109
研究發展費用	22	25
	\$ 180	191

2.確定提撥計畫

合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為8,595千元及8,657千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用之退休辦法，民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日認列之退休金費用分別為37,538千元及32,995千元。

4.南韓子公司BB部分職工退休金係屬確定福利退休計畫，民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及一一三年三月三十一日分別為淨確定福利資產5,781千元、12,710千元及5,753千元，列於其他非流動資產項下。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十五)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	<u>115年1月至3月</u>	<u>114年1月至3月</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 81,736	103,989
以前年度之調整	<u>-</u>	<u>(426)</u>
	<u>81,736</u>	<u>103,563</u>
遞延所得稅費用(利益)		
暫時性差異之發生	1,977	(9,291)
以前年度之調整	<u>-</u>	<u>(7,772)</u>
所得稅費用	<u>\$ 83,713</u>	<u>86,500</u>

2.合併公司認列於其他綜合損益之下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>115年1月至3月</u>	<u>114年1月至3月</u>
後續可能重分類至損益之科目：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>\$ (14,745)</u>	<u>26,615</u>

3.合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日並無認列於權益之所得稅費用。

4.截至民國一一五年三月三十一日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關分別核定至民國一一二年度及一一三年度。

5.本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」第39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十六)權益

1.股本

本公司民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日額定股本皆為9,000,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本皆為2,634,854千元，每股面額均為10元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 資本公積

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	271,508	271,508	232,065
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	104,726	104,726	109,924
	<u>\$ 2,290,130</u>	<u>2,290,130</u>	<u>2,255,885</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4. 特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。民國一一五年及一一四年三月三十一日，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5. 盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一五年三月十三日經董事會擬議民國一一四年度盈餘分配案及一一四年六月十九日經股東常會決議民國一一三年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	114年度		113年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 2.00	<u>526,971</u>	2.02	<u>526,971</u>

6. 庫藏股票

民國一一五年三月三十一日，本公司依證券交易法第28條之2規定，為轉讓予員工而買回之庫藏股共3,000千股，計141,417千元。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，不得享有股東權利。

另，民國一一五年及一一四年三月三十一日，鼎翰科技持有本公司普通股皆為15,960千股，買回成本為599,878千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一一四年度及一一三年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為32,888千元及31,920千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7. 其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國115年1月1日	\$ (275,634)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>100,119</u>
民國115年3月31日餘額	<u>\$ (175,515)</u>
民國114年1月1日	\$ (244,678)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>129,742</u>
民國114年3月31日餘額	<u>\$ (114,936)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十七)股份基礎給付

合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(十八)客戶合約之收入

1.收入之細分

	115年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 946,585	733,837	1,680,422
美 洲	156,120	1,094,778	1,250,898
歐 洲	507,533	934,552	1,442,085
其 他	14,666	2,349	17,015
	<u>\$ 1,624,904</u>	<u>2,765,516</u>	<u>4,390,420</u>

主要產品線：			
整流器	\$ 1,624,904	-	1,624,904
條碼列印機	-	2,765,516	2,765,516
	<u>\$ 1,624,904</u>	<u>2,765,516</u>	<u>4,390,420</u>

	114年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 1,080,509	973,919	2,054,428
美 洲	152,383	1,081,482	1,233,865
歐 洲	403,201	800,254	1,203,455
其 他	15,689	421	16,110
	<u>\$ 1,651,782</u>	<u>2,856,076</u>	<u>4,507,858</u>

主要產品線：			
整流器	\$ 1,651,782	-	1,651,782
條碼列印機	-	2,856,076	2,856,076
	<u>\$ 1,651,782</u>	<u>2,856,076</u>	<u>4,507,858</u>

2.合約餘額

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
應收票據及應收帳款	\$ 3,302,773	3,397,270	3,646,797
減：備抵損失	(82,520)	(82,298)	(68,497)
合 計	<u>\$ 3,220,253</u>	<u>3,314,972</u>	<u>3,578,300</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十九)營業外收益及費損

1.利息收入

合併公司之利息收入明細如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
銀行存款利息	\$ 4,193	6,259

2.其他收入

	115年1月至3月	114年1月至3月
租金收入	\$ 30	2,160
其 他	9,607	7,466
	\$ 9,637	9,626

3.其他利益及損失

	115年1月至3月	114年1月至3月
處分不動產、廠房及設備損失	\$ (5,150)	(2,064)
外幣兌換利益	45,112	58,110
透過損益按公允價值衡量之金融工具利益(損失)	3,641	(476)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	7	204
其 他	(3,860)	(3,094)
	\$ 39,750	52,680

4.財務成本

	115年1月至3月	114年1月至3月
利息費用	\$ (28,647)	(36,511)
減：利息資本化	141	244
其他財務費用	(11,091)	(13,470)
	\$ (39,597)	(49,737)

(二十)員工及董事酬勞

依本公司民國一一四年六月十九日修訂之章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。前述員工酬勞比例中，應提撥至少不低於百分之一作為基層員工酬勞分派數額。

本公司如有以前年度累積虧損，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

修訂前章程之規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一五年一月一日至三月三十一日員工(含基層員工)酬勞及一一四年一月一日至三月三十一日員工酬勞估列金額分別為11,678千元及8,391千元，董事酬勞金估列金額分別為1,946千元及1,357千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。

本公司民國一一四年度員工(含基層員工)酬勞及一一三年度員工酬勞估列金額分別為33,705千元及34,336千元，董事酬勞金估列金額分別為5,618千元及5,723千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一四年及一一三年合併財務報告估列金額並無差異。

(二十一)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	115年1月至3月	114年1月至3月
本期淨利	\$ 170,603	116,475
加權平均流通在外股數(千股)	244,525	247,525
基本每股盈餘(元)	\$ 0.70	0.47

2.稀釋每股盈餘

	115年1月至3月	114年1月至3月
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ 170,603	116,475
加權平均流通在外股數(千股)	244,525	247,525
員工酬勞	645	726
用以計算稀釋每股盈餘之當期流通在外普通股加權平均股數(千股)	245,170	248,251
稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.70	0.47

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十二)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
115年3月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,766,991	1,772,997	1,772,997	-	-	-
或有對價	59,143	59,143	59,143	-	-	-
應付帳款	1,659,493	1,659,493	1,659,493	-	-	-
其他應付款	732,859	732,859	732,859	-	-	-
租賃負債	722,373	823,042	204,769	221,604	396,669	-
長期借款(含一年內到期)	3,320,027	3,485,222	371,583	1,247,392	1,856,055	10,192
衍生金融負債						
遠期外匯合約	266	266	266	-	-	-
	<u>\$ 8,261,152</u>	<u>8,533,022</u>	<u>4,801,110</u>	<u>1,468,996</u>	<u>2,252,724</u>	<u>10,192</u>
114年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,540,103	1,546,747	1,546,747	-	-	-
或有對價	67,420	67,420	67,420	-	-	-
應付帳款	1,656,680	1,656,680	1,656,680	-	-	-
其他應付款	892,386	892,386	892,386	-	-	-
租賃負債	710,122	730,578	172,089	200,090	348,876	9,523
長期借款(含一年內到期)	3,520,111	3,714,870	473,658	931,308	1,188,329	1,121,575
衍生金融負債						
遠期外匯合約	175	175	175	-	-	-
	<u>\$ 8,386,997</u>	<u>8,608,856</u>	<u>4,809,155</u>	<u>1,131,398</u>	<u>1,537,205</u>	<u>1,131,098</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

114年3月31日	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 2,079,130	2,089,740	2,089,740	-	-	-
或有對價	93,198	93,198	64,350	28,848	-	-
應付帳款	1,550,308	1,550,308	1,550,308	-	-	-
其他應付款	721,660	721,660	721,660	-	-	-
租賃負債	692,019	803,030	188,235	149,149	459,441	6,205
長期借款(含一年內到期)	3,103,108	3,311,286	333,714	362,375	2,615,197	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	2,386	2,386	2,386	-	-	-
	<u>\$ 8,241,809</u>	<u>8,571,608</u>	<u>4,950,393</u>	<u>540,372</u>	<u>3,074,638</u>	<u>6,205</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	115.3.31		114.12.31		114.3.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
金融資產						
貨幣性項目						
美 元	31.995	\$ 3,027,326	31.430	2,486,713	33.205	2,193,940
歐 元	36.71	1,612,584	36.90	1,503,277	35.97	1,539,984
人 民 幣	4.629	511,410	4.496	2,462,679	4.573	2,285,804
日 幣	0.2005	9,134	0.2008	239,165	0.2227	222,600
英 鎊	42.27	1,716	42.33	12,796	43.05	11,667
港 幣	4.081	-	4.038	458,262	4.268	422,009
		<u>\$ 5,162,170</u>		<u>7,162,892</u>		<u>6,676,004</u>
衍生商品						
美 元	31.995	\$ 149	31.430	15	33.205	-
歐 元	36.71	-	36.90	376	35.97	-
		<u>\$ 149</u>		<u>391</u>		<u>-</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	115.3.31		114.12.31		114.3.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 元	31.995	\$ 1,410,728	31.430	1,121,866	33.205	959,707
歐 元	36.71	877,273	36.90	693,283	35.97	1,407,513
人 民 幣	4.629	1,027,179	4.496	439,324	4.268	622,979
日 幣	0.2005	66,808	0.2008	56,941	0.2227	72,052
英 鎊	42.27	1,997	42.33	-	43.05	-
港 幣	4.081	-	4.038	-	4.573	1,487
		<u>\$ 3,383,985</u>		<u>2,311,414</u>		<u>3,063,738</u>
<u>衍生商品</u>						
美 元	31.995	\$ 266	31.430	175	33.205	825
歐 元	36.71	-	36.90	-	35.97	1,561
		<u>\$ 266</u>		<u>175</u>		<u>2,386</u>

(2)敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一五年及一一四年三月三十一日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將分別增加或減少為53,342千元及108,296千元；兩期分析係採用相同基礎。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日外幣兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為45,112千元及58,110千元。

4.利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將減少或增加50,870千元及51,822千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5.其他價格風險：

如報導日金融資產價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

報導日證券價格	115年1月至3月		114年1月至3月	
	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益
上漲1%	\$ -	1,988	-	1,631
下跌1%	\$ -	(1,988)	-	(1,631)

6.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	115.3.31				
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 90,364	90,364	-	-	90,364
遠期外匯合約	149	-	149	-	149
國外基金	135,494	-	-	135,494	135,494
小 計	226,007	90,364	149	135,494	226,007
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,938,409	-	-	-	-
應收帳款	3,220,253	-	-	-	-
其他應收款	109,617	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	230,524	-	-	-	-
小 計	7,498,803	-	-	-	-
合 計	\$ 7,724,810	90,364	149	135,494	226,007
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 266	-	266	-	266
或有對價	59,143	-	-	59,143	59,143
小 計	59,409	-	266	59,143	59,409

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		115.3.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,659,493	-	-	-	-
其他應付款	732,859	-	-	-	-
租賃負債	722,373	-	-	-	-
銀行借款	5,087,018	-	-	-	-
小 計	8,201,743	-	-	-	-
合 計	\$ 8,261,152	-	266	59,143	59,409
		114.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 60,053	60,053	-	-	60,053
遠期外匯合約	391	-	391	-	391
國外基金	125,237	-	-	125,237	125,237
小 計	185,681	60,053	391	125,237	185,681
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,535,194	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,314,972	-	-	-	-
其他應收款	113,308	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	673,284	-	-	-	-
小 計	7,636,758	-	-	-	-
合 計	\$ 7,822,439	60,053	391	125,237	185,681
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 175	-	175	-	175
或有對價	67,420	-	-	67,420	67,420
小 計	67,595	-	175	67,420	67,595
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,656,680	-	-	-	-
其他應付款	892,386	-	-	-	-
租賃負債	710,122	-	-	-	-
銀行借款	5,060,214	-	-	-	-
小 計	8,319,402	-	-	-	-
合 計	\$ 8,386,997	-	175	67,420	67,595

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		114.3.31			
		公允價值			
帳面金額		第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 90,325	90,325	-	-	90,325
國外基金	90,955	-	-	90,955	90,955
小 計	181,280	90,325	-	90,955	181,280
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,652,300	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,578,300	-	-	-	-
其他應收款	119,019	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	270,561	-	-	-	-
小 計	7,620,180	-	-	-	-
合 計	\$ 7,801,460	90,325	-	90,955	181,280
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 2,386	-	2,386	-	2,386
或有對價	93,198	-	-	93,198	93,198
小 計	95,584	-	2,386	93,198	95,584
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,550,308	-	-	-	-
其他應付款	721,660	-	-	-	-
租賃負債	692,019	-	-	-	-
銀行借款	5,182,238	-	-	-	-
小 計	8,146,225	-	-	-	-
合 計	\$ 8,241,809	-	2,386	93,198	95,584

(2)衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A.非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B.衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3)公允價值等級間之移動

合併公司於民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(4)第三等級之變動明細表

	透過損益按 公允價值衡量 之金融資產
民國115年1月1日	\$ 125,237
總利益或損失	
認列於損益	2,424
取得	7,833
民國115年3月31日	<u>\$ 135,494</u>
民國114年1月1日	\$ 66,152
總利益或損失	
認列於損益	1,085
取得	23,718
民國114年3月31日	<u>\$ 90,955</u>

上述總利益或損失，係列報於「其他利益及損失」。其中與民國一一五年及一一四年三月三十一日仍持有之資產相關者如下：

	115年1月至3月	114年1月至3月
總利益或損失		
認列於損益(列報於「其他利益及損失」)	\$ 2,424	1,085

(5)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司公允價值歸類為第三等級具單一重大不可觀察輸入值，重大不可觀察輸入值之資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過損益按公允價值衡量之金融資產-國外基金	淨資產價值法	• 淨資產價值	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高
透過損益按公允價值衡量之金融負債-或有對價協議	選擇權評價模型	• 波動度、無風險利率、風險折現率及剩餘年限期數	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高

(二十三)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一四年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

(二十四)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一四年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一四年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(二十五)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	115.1.1	現金流量	非現金之變動			115.3.31
			匯率變動	其他	租賃給付之變動	
短期借款	\$ 1,540,103	226,888	-	-	-	1,766,991
長期借款	3,520,111	(178,775)	(21,309)	-	-	3,320,027
租賃負債	710,122	(45,029)	6,293	10,356	40,631	722,373
存入保證金	1,332	(49)	-	-	-	1,283
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 5,771,668</u>	<u>3,035</u>	<u>(15,016)</u>	<u>10,356</u>	<u>40,631</u>	<u>5,810,674</u>

	114.1.1	現金流量	非現金之變動			114.3.31
			匯率變動	其他	租賃給付之變動	
短期借款	\$ 2,286,701	(207,571)	-	-	-	2,079,130
長期借款	3,294,570	(191,960)	498	-	-	3,103,108
租賃負債	702,602	(22,145)	(2,187)	13,089	660	692,019
存入保證金	1,970	36	-	-	-	2,006
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 6,285,843</u>	<u>(421,640)</u>	<u>(1,689)</u>	<u>13,089</u>	<u>660</u>	<u>5,876,263</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二) 主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	115年1月至3月	114年1月至3月
短期員工福利	\$ 78,729	48,287
退職後福利	695	638
股份基礎給付	1,385	1,312
	<u>\$ 80,809</u>	<u>50,237</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十七)。

八、質押之資產

除附註六(十一)說明外，合併公司提供質押擔保之資產帳面金額明細如下：

資產名稱	質押擔保標的	115.3.31	114.12.31	114.3.31
不動產、廠房及設備	銀行借款	<u>\$ 108,775</u>	<u>70,201</u>	<u>87,273</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一) 合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	115.3.31	114.12.31	114.3.31
新台幣	\$ 3,320,480	3,320,480	2,108,000
美金	32,300	32,300	32,300

(二) 民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日，鼎翰科技因關稅保證等交易由銀行提供之履約保證皆為4,000千元。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十二、其 他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	115年1月至3月			114年1月至3月		
	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	297,570	485,743	783,313	286,038	445,227	731,265
勞健保費用	31,737	37,828	69,565	35,048	34,802	69,850
退休金費用	22,741	23,572	46,313	19,703	22,140	41,843
董事酬金	-	9,779	9,779	-	7,460	7,460
其他員工福利費用	25,750	25,053	50,803	24,413	21,763	46,176
折舊費用	191,468	40,999	232,467	197,092	35,095	232,187
攤銷費用	1,401	50,092	51,493	1,938	52,150	54,088

(二)營運之季節性：

合併公司之營運不受季節性或週期性因素影響。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一五年一月一日至三月三十一日合併公司依編製準則之規定，應揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1.資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	貸出資金 之 公 司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高餘額	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註2)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵損失 金 額	擔 保 品		對個別對象 資金貸與 限額(註3)	資金貸 與限額 (註4)
													名 稱	價 值		
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	-	-	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,113,878	2,227,756
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	220,260	108,295	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,113,878	2,227,756
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	220,260	-	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,113,878	2,227,756
1	鼎翰科技	MGN (原TSCPL)	其他應收款- 關係人	是	71,402	69,749	33,039	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,113,878	2,227,756
2	BB	BBES	其他應收款- 關係人	是	601	587	587	4.60%	2	-	營運周轉	587	無	-	427,450	854,899
3	DLS	鼎翰科技	其他應收款- 關係人	是	191,970	191,970	191,970	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	314,192	628,384

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係有短期融通資金之必要者。

註3：與鼎翰科技有短期融通資金之必要者，其額度以鼎翰科技最近期經會計師查核或核閱財務報表淨值之20%為限。鼎翰科技直接及間接持有表決權100%之國外公司間從事資金貸與或鼎翰科技持有表決權股份100%之國外公司對鼎翰科技從事資金貸與，其額度以不超過鼎翰科技最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之20%為限。

註4：鼎翰科技資金貸與他人之總限額，以鼎翰科技最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之40%為限。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註3)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	背書保證以財產設定擔保金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註3)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係(註2)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	2,227,756	191,970	191,970	-	-	3.45 %	3,341,633	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,227,756	239,963	239,963	-	-	4.31 %	3,341,633	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,227,756	239,963	239,963	-	-	4.31 %	3,341,633	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,227,756	1,503	1,468	-	-	0.03 %	3,341,633	Y	N	N

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係指直接及間接持有表決權之股份超過50%之公司。

註3：背書保證總金額及對單一企業背書保證最高限額分別為鼎翰科技當期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之60%及40%為限。

3. 期末持有之重大有價證券(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	群益安穩貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,759	30,134	-	30,134	
本公司	富蘭克林華美貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,480	60,230	-	60,230	
本公司	Achi Capital Partners Fund LP	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	135,494	-	135,494	

4. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(137,455)	(3) %		-		208,848	6 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(138,223)	(3) %		-		256,878	8 %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	561,752	19 %		-		(500,119)	(30) %	註2
本公司	天津長威	孫公司	進貨	100,002	3 %		-		(15,840)	(1) %	
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(305,121)	(7) %		-		803,034	25 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(117,636)	(3) %		-		393,505	12 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	282,497	9 %		-		(284,925)	(17) %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應收付帳款係以淨額列示。

註3：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

5. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金 額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	208,848	2.63%	-		48,311	-
本公司	TSCA	孫公司	256,878	2.73%	-		38,740	-
陽信長威	本公司	孫公司	500,119	5.55%	-		116,128	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	803,034	1.63%	292,014		104,066	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	393,505	1.23%	212,382		20,581	-
鼎翰科技	MGN	子公司	143,119	-%	-		-	-
天津國聚	鼎翰科技	子公司	284,925	3.09%	-		76,301	-

註1：截至115年4月30日止收回金額。

註2：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

6. 母子公司間業務關係及重大交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之 關 係	115年第一季交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
0	本公司	TSCE	1	推銷費用 — 佣金支出	39,153	按月支付	0.86 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	20,873		0.10 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	82,469	註三	1.81 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	50,763		0.24 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	137,455	按月支付	3.01 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	208,848		0.97 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	603		- %
0	本公司	TSCH	1	應付費用	142		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	138,223	註三	3.03 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用 — 佣金支出	1,465		0.03 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	256,878		1.20 %
0	本公司	TSCA	1	其他應收款	11,547		0.05 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,739		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	62,507	按月支付	1.37 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	33,124		0.15 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	85		- %
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	80,007		1.75 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	561,752	註四	12.32 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	500,119	註五	2.33 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	100,002		2.19 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	15,840		0.07 %
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	63,310		0.29 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	235,097	註三	5.15 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	270,082		1.26 %
2	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	47,401	註三	1.04 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

註六：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一五年一月一日至三月三十一日合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元/千股

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註4)			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,538,527	(8,334)	(8,334)	子公司 (註6)
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,983,789	24,997	24,997	子公司 (註6)
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	-	2,845	-	- %	-	-	-	子公司 (註6)
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	59,367	(613)	(613)	子公司 (註6)
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	146,412	3,102	3,102	子公司 (註5)
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	715,729	67,160	10,268	子公司 (註6)
本公司	鼎翰科技	台灣	標籤印表機之製造及買賣	163,728	163,728	16,995	35.74 %	1,292,234	217,001	77,556	子公司 (註5)
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	120,024	(43,987)	(32,991)	子公司 (註6)
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,375,059	67,160	24,822	子公司 (註6)
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	40,008	(43,987)	(10,996)	子公司 (註6)
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	472,240	10,760	10,760	子公司 (註6)
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,407,055	67,160	25,400	子公司 (註6)
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,727,753	53,174	53,174	子公司 (註5)
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	681,961	5,567	5,567	子公司 (註6)
鼎翰科技	TSCAE	德國	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	2,943	2,943	註1	100.00 %	2,010	(2,387)	(2,387)	子公司 (註5)
鼎翰科技	TSCAA	美國	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,116,797	(18,748)	(18,748)	子公司 (註5)
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資	47,468	47,468	12,711	100.00 %	849,368	4,289	4,289	子公司 (註5)
鼎翰科技	DLS	美國	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	1,570,959	8,951	8,951	子公司 (註5)
鼎翰科技	TSCIN	印度	承租資產	2,791	2,791	710	100.00 %	1,551	101	101	子公司 (註5)
鼎翰科技	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	498,227 (註7)	-	2	100.00 %	483,803	(9,952)	(9,952)	子公司 (註5)
鼎翰科技	TSCPL	波蘭	一般投資	註7	498,227	-	- %	-	(1,088)	(1,088)	子公司 (註5)
鼎翰科技	BB	韓國	經營企業行動電腦及其零件之買賣	2,856,995	2,856,995	7,010	99.85 %	3,080,254	89,298	74,719	子公司 (註5)
鼎翰科技	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其零件之買賣	註3	註3	註1	0.03 %	3	(2,866)	(1)	子公司 (註5)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備 註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註4)			
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	標籤印表機及其零件之買賣	8,234	8,234	註1	100.00 %	(16,575)	140	140 (註5)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	承租資產	124	124	註1	100.00 %	4,013	152	152 (註5)	子公司
DLS	PPL	美國	印表機各式標籤紙及其耗材之買賣	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	61,272	1,956	1,956 (註5)	子公司
TSCPL	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	- (千波蘭幣) (註7)	71,613 (千波蘭幣)	註1	- %	-	(5,678)	(5,678) (註5)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	標籤印表機及其零件之產銷	47,993	47,993	註1	100.00 %	860,638	4,290	4,290 (註5)	子公司
BB	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其零件之買賣	5	5	註1	99.97 %	5	(2,866)	(2,865) (註5)	子公司
BB	BBUS	美國	款項代收	2,920	2,920	註2	100.00 %	-	(47)	(47) (註5)	子公司
BB	BBIN	印度	研發及設計企業行動電腦、技術服務	4,078	4,078	990	99.00 %	4,964	(358)	(355) (註5)	子公司
BB	BBDE	德國	協助行銷服務	756	756	註1	100.00 %	-	1,265	1,265 (註5)	子公司
BB	BBES	西班牙	因投標要求而設立	1,265	1,265	註1	100.00 %	1,054	(46)	(46) (註5)	子公司
BB	BBJP	日本	經營企業行動電腦及其零件之買賣	2,086	2,086	1	100.00 %	2,014	(136)	(136) (註5)	子公司

註1：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

註2：持有股數未滿仟股，故未列示。

註3：金額未滿仟元，故未列示。

註4：帳面金額係減除未實現銷貨利益後之淨額。

註5：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註6：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

註7：MGN以8,754千元反向收購TSCPL之所有股份，收購完成後由本公司持有MGN 100%股權，於民國一五年二月二十七日經波蘭法院登記完成並正式生效。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大 陸 被 投 資 公司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被 投 資 公 司 本期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣 業務	4,461	(二)	4,461	-	-	4,461	10,760	100.00 %	10,760	472,240	709,512 (註2)
陽信長威	整流器之製造 及買賣業務	1,667,160	(二)	628,196	-	-	628,196	53,174	100.00 %	53,174	2,727,753	250,864
天津長威	晶片之製造及 買賣業務	387,173	(二)	387,173	-	-	387,173	5,567	100.00 %	5,567	681,961	452,102
天津國聚	標籤印表機及 其零件之產銷	48,605	(二)	47,993	-	-	47,993	4,290	35.74 %	1,533	860,638	998,407

註1：編號(二)係指透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：未包含盈餘轉增資40,058千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
1,088,133	2,143,109	4,748,137

註：本公司所投資Achi Capital Partners Fund LP基金，因其轉投資大陸地區，使本公司增加投審會核准額度USD773千元。另有新增投資8,576千元(美金268千元)已匯出尚在經濟部投資審議司核備中。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一五年一月一日至三月三十一日與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項(於編製合併報告時業已沖銷)，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

115年1月至3月				
	整流器部門	條碼印表機 部 門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,624,904	2,765,516	-	4,390,420
部門間收入	1,464	23	(1,487)	-
收入合計	<u>\$ 1,626,368</u>	<u>2,765,539</u>	<u>(1,487)</u>	<u>4,390,420</u>
應報導部門損益	<u>\$ 126,807</u>	<u>267,062</u>	<u>-</u>	<u>393,869</u>
114年1月至3月				
	整流器部門	條碼印表機 部 門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,651,782	2,856,076	-	4,507,858
部門間收入	1,347,263	17	(1,347,280)	-
收入合計	<u>\$ 2,999,045</u>	<u>2,856,093</u>	<u>(1,347,280)</u>	<u>4,507,858</u>
應報導部門損益	<u>\$ 96,032</u>	<u>226,517</u>	<u>-</u>	<u>322,549</u>
應報導部門資產				
115年3月31日	<u>\$ 23,825,364</u>	<u>12,854,472</u>	<u>(15,204,885)</u>	<u>21,474,951</u>
114年12月31日	<u>\$ 23,421,749</u>	<u>12,649,871</u>	<u>(14,876,345)</u>	<u>21,195,275</u>
114年3月31日	<u>\$ 23,229,790</u>	<u>12,586,373</u>	<u>(14,272,773)</u>	<u>21,543,390</u>